

《水と表面》表面のウェット・ナノプロセスの最前線

—固液反応、水・洗浄・加工・計測技術—

主催：日本表面科学会関西支部、表面技術協会関西支部、神戸大学研究基盤センター
協賛：エレクトロニクス実装学会、応用物理学会、応用物理学会関西支部、化学工学会、近畿アルミニウム表面処理研究会、軽金属学会、高分子学会、触媒学会、精密工学会、電気化学会、電気化学会関西支部、電気学会、電気鍍金研究会、電子情報通信学会、日本セラミックス協会、日本トライボロジー学会、日本化学会、日本機械学会、日本金属学会、日本顕微鏡学会、日本材料科学会、日本材料学会、日本質量分析学会、日本真空協会、日本鉄鋼協会、日本表面処理機材工業会、日本物理学会、日本分析化学会、日本油化学会、腐食防食協会（依頼中を含む）

日時：2012年1月18日（水曜日） 13:00～17:30頃

場所：神戸大学百年記念館六甲ホール（神戸市）

定員：200名

参加費：無料

内容：

固体表面の機能化には多くの場合、水や液体が重要な働きをいたします。中でもエッチング液中における固体表面の反応制御は、半導体ウェーハ基板表面を清浄化し、更には構築されたデバイス機能の質を高める上で重要であり、半導体産業の根幹の一役を担っています。また、これら固液反応はウェーハ洗浄の重要な要素ですが、最近では精度の高い製造プロセス技術へと展開されてきています。ミラー作製、難加工物など広範囲に渡る精密なナノスケールの加工技術は、加工面での反応メカニズムの科学的解明、「ものづくり」を高度化するのに必須な精密測定技術とともに進歩してきております。このようなウェット・ナノプロセス技術は将来においても産業の重要な基盤技術となります。

講演プログラム：

開会の挨拶

酒井 明（日本表面科学会関西支部支部長）

1. シリコン表面の室温三工程洗浄技術と超高速ウェットエッチングによるウェーハ薄化技術（基調講演）
大見 忠弘（東北大学）

2. 超純水—限りなく H₂O に近い水—がもたらす超清浄表面

川田 和彦（オルガノ(株)）

3. 第一原理シミュレーションで観る固液界面の構造および電気化学反応

大谷 実（産業技術総合研究所）

（休憩）

4. ウェットエッチングによる SiC、GaN 表面の原子スケール平滑化

山内 和人（大阪大学）

5. ナノメートル形状計測における不確かさ評価とナノメートル標準の構築

高増 潔（東京大学）

閉会の挨拶

藤原 裕（表面技術協会関西支部支部長）

申し込み締切り：2012年1月11日（水）

申し込み方法：<http://www.sssj.org/Kansai/goudou120118.html> での ONLINE 申し込みを推奨します。

問い合わせ先：社団法人日本表面科学会関西支部幹事 服部 賢

〒630-0192 生駒市高山町 8916 番地の 5 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科

Tel/Fax: 0743-72-6021/6029 E-mail: khattori@ms.naist.jp

会場案内：〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1TEL：078-803-5294

アクセスマップ <http://www.kobe-u.ac.jp/info/access/rokko/rokkodai-dai2.htm>

阪急電車六甲駅、JR六甲道駅、又は阪神電車御影駅から市バス 36 系統に乗車「神大文理農学部前」下車
新幹線「新神戸」駅からタクシーで約 15 分